

证券代码：688233

证券简称：神工股份

## 锦州神工半导体股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位及人员	平安基金、金信基金、汐泰资管、檀真资管、尚诚资管、国力民生、中大君悦、道翼投资、信达澳亚、赋格投资、峰瑞资本、第五公理、长江证券、东吴基金、路博迈基金、混沌投资、嘉实基金、云锡投资、工银理财、摩根士丹利、长城财富保险资管、途灵资管、华泰资管、元太资本、禹田资管、横琴智合远见、兆天投资、金信基金、复胜资管、光大证券、东方睿石、财通证券资管、呈瑞投资、和谐健康保险、长江证券、建信基金、国华兴益保险资管、华福证券、中信资管、西南证券、国联证券、东北证券、浦银安盛、长城基金、中邮证券、国信证券、国元证券、长城证券、国君海通、睿郡资产、中信资管
时间	2025年4月27日
地点	线上会议
接待人员	董事会秘书常亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司本季度净利润增长的主要来源</b></p> <p>2025年第一季度，公司业绩延续2024年以来的良好态势：</p> <p>主力业务大直径硅材料，得益于下游集成电路制造厂商的终端需求驱动，销售额有所增长。报告期内公司持续扩大客户订单规模，市场拓展取得一定成效。</p> <p>成长型业务硅零部件，聚焦中国本土市场供应，销售额保持稳步增长，重点客户出货数量持续增加。公司不断配合客户进行新产品的研发，并逐渐转为量产应用，已经在中国本土半导体供应链安全的建设中发挥独特作用。</p> <p>2024年至今的几个季度，公司大直径硅材料业务的盈利能力得到修复和增强，收入规模逐渐恢复；硅零部件业务从导入期进入到成长期，实现了收入体量</p>

的较大增长，对公司净利润的增长贡献较大。

## 二、公司业绩有哪些结构性变化

2025年第一季度的业绩，需要结合2024年全年数据来分析。

管理层较为关注2024年度业绩的如下结构性变化：

第一，公司主力业务大直径硅材料的毛利率已经恢复到约64个点，继续保持着领先的盈利能力；

第二，公司成长型业务硅零部件占公司总营收的比重，已经达到了约40%，公司第二增长曲线已经确立，业绩稳定性增强；

第三，公司的境内业务收入占主营收入的比重，已经达到了约70%，公司在中国半导体供应链国产化中取得了显著成绩。

## 三、大直径硅材料和硅零部件业务的业绩增长持续性

宏观角度分析，公司认为这两大业务受到如下两大趋势的推动：

第一大趋势，是科技巨头对人工智能数据中心的资本开支，带动了先进制程高端芯片的需求增加，而高端芯片产品对刻蚀工艺的用量较大，因此一定程度上拉动了一批集成电路制造厂的开工率和资本开支，最终带动了公司主力业务大直径硅材料；

第二大趋势，是中国大陆半导体产能的快速扩张，带动了本土设备厂商的出货量，拉动了公司成长型业务硅零部件。

公司原生植根于全球半导体产业链，正在中国本土半导体供应链中发挥独特作用，业绩增长的可持续性较为坚实。

微观角度分析，公司是全球范围内较少的“从硅材料到硅零部件”的一体化生产商，在研发能力和成本控制两方面都具备扎实基础。目前公司硅零部件业务受益于中国芯片产能国产化，在手订单饱满，产能利用率较高，正在进行持续扩产，力争在年内实现更高的生产规模和稳健的良率水平，以此实现更好业绩；大直径硅材料业务方面，公司目前产能利用率仍处于低位，销售价格稳定，随着半导体产业上行周期将真正到来，该业务的弹性有望显现。

#### 四、半导体周期

展望2025年，公司认为当前半导体产业正处于“换挡变速”的前夜：

全世界连续数年的巨额研发费用和资本开支持续灌注，催生了可观的芯片制造及封装产能，不仅带动了设备、零部件、材料需求，还极大地降低了下游技术创新的财务成本和机会成本；

年初以来，大语言模型，尤其是以DeepSeek为代表的开源模型的重大进展，打破了科技巨头对数据、算法、算力的“闭环”垄断，为包括中国在内的全球各地开发者获得强大且廉价的算力铺平了道路。

上游芯片产能上了新台阶，中游“算力平权”势不可挡。因此，下游应用端的新一代主流消费电子产品，已经呈现百花齐放的态势：智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能可穿戴设备等等，名目繁多，日新月异。

基于以上终端创新，假以时日，半导体产业上行周期将真正到来，公司业绩的弹性有望显现。

#### 五、2025年发展战略

大直径硅材料业务方面，公司在全球细分市场的产能和技术方面居于领先地位，盈利能力已经得到修复并增强。公司将继续扩大优势产品的先发优势，紧密跟踪全球市场先进制程设备的最新技术要求，牢牢抓住快速增长的中国本土市场；

硅零部件业务方面，公司将以下游客户订单为基础扩大产能，在确保良率及毛利率的前提下，继续保持以高端产品为主的销售结构，与中国本土等离子刻蚀设备厂商携手奋进，提升在中国主流集成电路制造厂商特别是存储类厂商的市场占有率；

8吋半导体硅片业务方面，公司将继续争取获得主流芯片制造厂的认证通过及批量订单，延续去年行之有效的降本增效措施，不懈追求评估认证和经济效益的最佳平衡。公司还将积极发挥技术优势，深挖定制化潜力，拓展细分利基市场，形成差异化优势。

纵观国际半导体材料行业的发展历史，优质企业需要在做好内涵式发展的同

	时，通过外延式发展获得更快的成长加速度，公司亦不例外。公司管理层将在不断夯实主业的大前提下，积极探索国内外行业内的协作机会，注重资产质量以及主业协同性，扎实稳妥地推进外延式发展，为股东带来更好的回报。
附件清单	无
日期	2025 年 4 月 27 日